



深圳丹邦科技股份有限公司

Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.

(注册地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）



(注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股流通股，发行后总股本为16,000万股，16,000万股均为流通股。

公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍及公司股东深圳市丹依科技有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东益关寿、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

除此之外，公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

二、根据公司2010年9月15日通过的2010年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享。截至2010年12月31日，母公司未分配利润为8,981.52万元。

三、2007年5月，控股股东丹依发展以“UV固化可剥离压敏胶膜”、“一种无胂刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”四项发明专利对丹邦有限出资。根据深圳中联岳华会计师事务所出具的深中岳评报字[2007]第007号资产评估报告书，四项发明专利于评估基准日2006年12月31日的评估值为4,843万元，经2007年1月28日丹邦有限董事会决议同意，丹依发展以上述无形资产的评估值为参考作价4,623万元出资至丹邦有限，占此

次增资完成后公司注册资本的46.23%。

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）所得税优惠被追缴的风险

2007年5月，公司外资股权比例从25%变更为12.67%，成为“外资比例低于25%”的外商投资企业。根据国家税务总局有关规定，公司于2007年5月外资比例低于25%之后应补缴已免征、减征的企业所得税税款。

但根据深圳市地方法规的相关规定，公司作为在深圳经济特区内设立的生产性企业，可享受按优惠税率及减半征收企业所得税的税收优惠政策。公司2006年为开始获利年度，据此2006年度至2007年度可免征企业所得税，2008年度至2010年度减半征收企业所得税。深圳市南山区地方税务局于2011年1月24日出具确认函确认发行人无需补缴2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款。但若该具体行政行为被国家有权机关作出撤销的决定或人民法院作出撤销或认定无效的判决，则发行人2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款可能存在被追缴的风险。

（二）资产抵押风险

截至2011年6月30日，公司将主要生产用房屋建筑物、机器设备、发明专利等资产为公司的银行借款提供抵押或质押担保。根据抵押合同及质押合同的约定，如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，上述公司资产将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该房屋建筑物、机器设备及专利技术的所有权，进而影响正常生产经营的风险。

第二节 本次发行概况

1、股票种类	人民币普通股（A股）	
2、每股面值	1.00 元	
3、发行股数	4,000 万股，占发行后总股本的 25%	
4、每股发行价格	通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格	
5、市盈率	[] 倍（每股收益按照 2010 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）	
6、发行前每股净资产	2.36 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）	
7、发行后每股净资产	[] 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）	
8、发行方式	采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式	
9、发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	
10、预计募集资金总额	约[] 亿元	
11、预计募集资金净额	约[] 亿元	
12、承销方式	主承销商余额包销	
13、发行费用概算	承销及保荐费用	本次发行募集资金总额的[]
	律师费用	[] 万元
	审计费用	[] 万元
	发行手续费用	[] 万元

注：本招股意向书摘要中的简称与招股意向书中的简称具有相同含义。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

- 1、中文名称：深圳丹邦科技股份有限公司
- 2、英文名称：Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd.
- 3、注册资本：12,000万元
- 4、法定代表人：刘萍
- 5、成立日期：2001年11月20日
- 6、股份公司设立日期：2009年6月5日
- 7、公司住所：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
- 8、邮政编码：518052
- 9、联系电话：0755-26511518
- 10、传真号码：0755-26981718
- 11、互联网地址：<http://www.danbang.com/>
- 12、电子信箱：szdbond@danbang.com

二、发行人的历史沿革和改制重组情况

（一）发行人设立方式及发起人

本公司系由丹邦有限整体变更设立的股份有限公司。2009年2月23日，丹邦有限股东丹邦投资、丹依科技、益关寿、信瑞鸿网络、华浩投资、百顺投资作为发起人签订《发起人协议》，同意丹邦有限整体变更设立为股份有限公司。2009年6月5日，丹邦科技在深圳市工商行政管理局登记注册成立。

（二）发起人投入的资产内容

发行人由丹邦有限整体变更设立，继承了丹邦有限的全部资产、负债和权益。根据开元信德会计师出具的深审字（2009）第148号《审计报告》，丹邦有限截至2008年12月31日所拥有的主要资产为：流动资产17,337.14万元，其中存货为

998.44万元；非流动资产为31,719.08万元，其中固定资产为27,179.16万元、无形资产为4,148.44万元。

发行人成立时继承了丹邦有限的全部业务：从事FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产和销售。

三、有关股本的情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通和锁定安排

公司本次发行前总股本12,000万股，本次拟公开发行4,000万股，公司发行前后股本变动情况如下：

单位：万股

类别	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例
有限 售条 件的 股份	丹邦投资集团	7,311.60	60.93%	7,311.60	45.70%
	丹依科技	2,160.00	18.00%	2,160.00	13.50%
	益关寿	1,520.40	12.67%	1,520.40	9.50%
	信瑞鸿网络	480.00	4.00%	480.00	3.00%
	华浩投资	480.00	4.00%	480.00	3.00%
	百顺投资	48.00	0.40%	48.00	0.30%
	有限售条件的股份小计	12,000.00	100.00%	12,000.00	75.00%
本次发行的股份	-	-	4,000.00	25.00%	
总计		12,000.00	100.00%	16,000.00	100.00%

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况参见第一节“重大事项提示”。

(二) 前十名股东、前十名自然人股东持股情况

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例	是否发起人	股权性质
1	丹邦投资集团	7,311.60	60.93%	是	法人股
2	丹依科技	2,160.00	18.00%	是	法人股
3	益关寿	1,520.40	12.67%	是	自然人股
4	信瑞鸿网络	480.00	4.00%	是	法人股
5	华浩投资	480.00	4.00%	是	法人股

6	百顺投资	48.00	0.40%	是	法人股
	合计	12,000.00	100.00%	-	-

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，实际控制人刘萍通过丹邦投资集团间接持有公司60.93%的股份，刘萍的侄子刘文魁通过丹依科技间接持有公司9%的股份。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营业务及主要产品

本公司自成立以来专注于FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产与销售，致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。

1、FPC 简介

FPC是柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介，作为印制电路板的一种重要类别，广泛应用于手机、笔记本电脑、液晶显示器、等离子显示器、数码相机以及硬盘、光驱、PC配件等消费电子产品，2009年全球FPC产值占全球印制电路板总产值的16.1%。

2、COF 柔性封装基板简介

COF柔性封装基板作为印制电路板产品中的重要高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板。在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。

3、COF 产品简介

COF产品是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。COF产品的作用是通过柔性基板与液晶面板连接导通芯片，由芯片驱动和控制液晶面板电流、电压从而改变液晶状态显示不同画面。COF产品广泛应用于液晶电视、智能3G手机及笔记本电脑等产品液晶屏的显示驱动。

（二）产品销售方式和渠道

公司产品以出口为主，报告期内产品外销比例均保持在98%以上，产品销售市场主要集中于日本、欧美、东南亚（包括韩国）、香港等国家和地区。公司境外销售分为三种情况：直接出口、转厂出口、通过丹邦香港（2009年8月以前为第比尔国际）代理出口。公司国内销售主要采取向客户直接销售的内销模式。

（三）所需主要原材料

公司生产所需原材料品种较多，主要包括铜箔、PI膜、保强板、粘合剂、芯片及器件等，其中PI膜大部分由境外进口，保强板、粘合剂、芯片及器件大部分由境内采购，铜箔境内、境外采购数量相当。公司在境外及境内均具有良好的采购和配套渠道，在多年的经营中，公司已与多家原材料生产厂商建立了长期稳固的合作关系，且每种主要原材料供应商数量保持两家以上，原材料来源和质量有保证。与此同时，珠三角地区电子元器件生产供应厂商众多，元器件供应充足。

公司生产所需能源主要为水和电力，由深圳供水、供电系统供应，报告期内供应稳定。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1、市场竞争概况

FPC 产品市场集中度较低，呈现高度分散的竞争格局，中国大陆目前有 100 多家 FPC 生产企业；COF 柔性封装基板全球市场份额长期被日本、韩国领先企业高度垄断。2009 年，销售额排名前七位的企业占全世界销售额的 97%，呈现高度集中的竞争格局。本公司主导产品在全球和中国的主要竞争对手情况如下：

序号	产品类别	主要竞争对手	
		全球主要竞争对手	中国主要竞争对手
1	FPC	NOK、Multek、Hitachi Chemical	珠海紫翔电子、安捷利电子、珠海元盛电子
2	COF柔性封装基板、COF产品	日立电线、三井金属矿业、LG Micron、STEMCO	索尼凯美高

2、发行人在行业中的竞争优势及地位

（1）领先的技术优势

经过多年的技术攻关和生产实践，公司成功掌握具有国际先进水平的三项核心技术：高性能薄膜成型技术、高密度微细线路制造技术及基于柔性基板的芯片封装技术，并运用上述技术实现了高端2L-FCCL、COF柔性封装基板及COF产品的产业化，填补了我国在高端柔性覆铜板材料及柔性封装基板领域的技术空白，打破了日本、韩国等国家和地区企业对关键材料的技术垄断。

公司的技术水平在国内同行中处于领先地位，部分技术接近国际尖端水平。公司承担的“高性能特种挠性电路连接与封装技术”项目是为了满足国家航天、航空、舰艇、兵器等军事电子装备的应用需求，为我军武器装备的发展和进步提供技术支撑。公司的技术研发项目如线宽线距 $20\ \mu\text{m}$ 的超微细化线COF柔性封装基板和厚度小于 $10\ \mu\text{m}$ 的高端2L-FCCL基膜是根据国际上最新的技术发展方向所做的前瞻性研究，符合电子信息产品轻薄短小的发展趋势，是公司在未来几年内持续保持技术领先的保证。

公司目前已获得发明专利9项，并且公司有多项产品和科技成果荣获国家级或省级新产品奖以及科技成果奖，其中：COF封装基板在2010年被国家科技部认定为“国家重点新产品”；先进COF超微线路及封装产业化项目被深圳市政府评为2006年度“深圳市科技创新奖”，并被广东省政府评为2007年度“广东省科学技术三等奖”。

2009年1月，公司作为项目联合单位开始承担国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发”课题研究任务。2011年2月，公司子公司广东丹邦作为项目责任单位获批承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目下属的“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目。国家科技重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定了大型飞机、极大规模集成电路制造装备与成套工艺等16个重大专项，这些重大专项是我国到2020年科技发展的重中之重。

（2）完整的全产业链布局

公司专注于微电子柔性互连与封装业务，形成了从 FCCL→FPC、FCCL→COF 柔性封装基板→COF 产品的完整产业链，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。

FCCL是生产FPC及COF柔性封装基板的主要原材料，占整个产品成本的40%-50%左右，但国内能够生产高档FCCL的企业非常少，特别是高端2L-FCCL基本靠进口。本公司打破日本、韩国等国对高端FCCL的技术垄断，实现了上游关键原材料柔性封装基板用高端2L-FCCL、FPC用3L-FCCL和普通2L-FCCL的自产，使得公司产品具有明显成本优势，增强了产品的市场竞争力，提升了公司的行业地位。同时，由于公司实现了上游关键原材料的自产，并严格控制产业链各个中间产品的质量，确保工艺流程的顺畅，使得公司产品能够长期保持稳定的质量水平，产品质量的稳定有利于公司形成稳定的客户关系。

（3）优质的客户资源

公司先进的技术水平、稳定的产品质量和可靠的产品性能在下游客户中赢得了良好的声誉并获得客户的广泛认可，目前，公司与多家世界500强企业及全球知名的电子信息产品品牌制造商建立了持久稳定的客户关系，已成为日本电产、夏普、佳能、日立、JVC、三洋电机等全球知名的电子信息产品品牌制造商的高端柔性电路板、COF柔性封装基板及COF产品的重要供应商之一，产品远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区，在FPC、COF柔性封装基板及COF封装领域形成了较高的知名度和良好的信誉度。

本公司的COF柔性封装基板及COF产品主要用于上述国际顶尖电子信息产品制造商的高端产品（比如本公司销售给佳能（Canon）影像器材用的COF柔性封装基板及COF产品均是用于1,000万像素以上的照相机）。在与国际顶尖电子信息产品生产商的合作过程中，公司能够汲取最新的国际生产经营理念，把握行业动态和技术走向，为进一步开拓市场创造有利条件。

（4）突出的行业地位

本公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极

少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。

公司2008年、2009年连续两年成为中国最大的COF柔性封装基板生产商，全球市场占有率分别为1.1%、1.55%，全球市场占有率稳步提高，2009年成为全球第八大COF柔性封装基板生产商。

公司是国家级高新技术企业，是国家科技部认定的“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”，拥有“国家挠性电路与材料研发中心”。2009年1月、2011年2月，公司及子公司广东丹邦先后获批承担国家科技重大专项（02专项）的课题研究任务及项目，国家科技重大专项是国家支持行业发展的具体举措，承担国家科技重大专项是国家对本公司技术研发水平、行业领先地位的肯定，对于公司产品档次升级和提升公司核心竞争力具有非常重要的意义。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

截至本招股意向书摘要签署之日，公司持有12项国内注册商标，取得9项发明专利。

本公司及控股子公司目前共拥有2宗土地使用权，1宗位于广东省深圳市南山区、1宗位于广东省东莞市松山湖，上述地块已经建设工业厂房及配套房产，或用作公司员工宿舍。

公司的主要设备主要从日本、美国进口，包括LCP净化涂布机装置、微电子涂布机、特殊雾围R-R热处理工程装置、电磁加热覆合机等设备，主要设备达到国际先进水平。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

本公司控股股东丹邦投资集团无实际的生产经营业务，目前主营业务为投资兴办实业，除投资本公司外，还持有第比尔国际、典邦科技及广东东邦的股权，因此丹邦投资集团与本公司不存在同业竞争关系。

本公司的实际控制人为刘萍，除投资丹邦投资集团及其下属企业外，无其他

实际控制企业，没有自营或者为他人经营与本公司同类的业务，故刘萍先生与本公司不存在同业竞争。

典邦科技主要从事液晶显示模组的代工业务，即根据客户的委托，由客户提供加工液晶显示模组所需的样品、原材料及有关技术资料，代为生产加工液晶显示模组产品，并收取一定代工费。典邦科技和本公司的主营业务与产品分属不同领域，主要体现在以下几个方面：①产品属于不同行业；②产品物理构成及特征明显不同；③产品功能用途存在本质差异且不具有类似性及相互替代的可能性；④在下游应用及客户方面不存在相互竞争关系。综上所述，典邦科技未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

广东东邦尚未开展生产与销售活动，成立后主要从事建设实施本次募投项目所需的生产厂房、研发大楼及生活配套设施等活动，广东东邦经营范围主要从事液晶显示器件的生产与销售业务，不会从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

第比尔国际曾是本公司境外销售和采购的重要窗口公司，主要职能就是满足部分客户及供应商的要求、充分利用香港商业发达的贸易环境、集中境外客户资源和外资银行资源、办理银行结算手续、代收客户货款、代付供应商采购款、协助报关等。截至2009年8月，公司通过第比尔国际的境外销售及采购合同（订单）全部履行完毕，境外采购或销售不再通过第比尔国际进行。此后，第比尔国际仅作为一家境外投资主体而存在，与本公司不存在同业竞争。

（二）主要关联交易情况

1、通过关联方进行部分境外销售和采购

2009年8月之前，公司部分境外销售及境外原材料、设备采购在形式上经由实际控制人刘萍在香港设立的第比尔国际进行，具体情况如下：

（1）销售商品

单位：万元

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
向第比尔国际销售商品的金额	-	-	404.64	5,842.88
主营业务收入	-	-	18,254.82	17,139.84

关联交易占主营业务收入比重	-	-	2.22%	34.09%
---------------	---	---	-------	--------

产生上述关联销售的原因是本公司在2008-2009年部分境外销售通过第比尔国际进行。自2008年5月起,本公司全资子公司丹邦香港开始承接原来通过第比尔国际进行的境外销售的职能。2009年,本公司通过第比尔国际的关联销售金额和占比均大幅度降低,2010年已不再发生该类关联交易。

(2) 采购原材料、设备

单位:万元

关联采购	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
向第比尔采购原材料的金额	-	-	965.82	2,560.90
向第比尔采购设备的金额	-	-	3,170.05	3,674.95
向第比尔采购商品的总金额	-	-	4,135.87	6,235.85
公司采购总额	-	-	12,705.48	8,737.53
关联采购占公司采购的比重	-	-	32.55%	71.37%

产生上述关联采购的原因是本公司在2008-2009年部分境外设备与原材料采购通过第比尔国际进行,本公司向第比尔国际采购商品的价格与第比尔国际向境外供应商采购商品的价格相一致。

自2008年5月起,本公司全资子公司丹邦香港开始承接原来通过第比尔国际进行的境外采购职能。因此,2009年,本公司通过第比尔国际的关联采购金额和占比均大幅度降低,2010年已不再发生该类关联交易。

2、向关联方转让设备

2008年7月18日,丹邦有限向典邦科技出售一批设备,转让价格以评估值参考确定为7,940,472.11元。典邦科技已于设备移交前支付完毕上述设备转让价款。该批设备系一批用于异方导电膜的研发设备,根据公司业务发展规划,公司专注于FPC、COF柔性封装基板等产品的研发与生产,于是将该批设备出售给典邦科技。

3、收购土地使用权、地上建筑物及附着物

2010年9月13日,本公司子公司广东丹邦与实际控制人控制的广东东邦签署了《资产收购协议书》。根据该《资产收购协议书》,广东丹邦拟收购广东东邦位于东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区,土地面积为56,964平方米的土地使

用权（宗地号为1935030100045）及其地上建筑物、附着物用于实施募集资金投资项目。

2011年4月15日，广东丹邦与广东东邦签署《补充协议》，广东丹邦以审计账面值为参考作价63,482,104.02元购买广东东邦拥有的上述土地使用权和在建工程。广东丹邦已向广东东邦支付全部转让价款，2011年5月9日，广东丹邦取得东莞市人民政府颁发的1935030100045号宗地的《国有土地使用证》（东府国用[2009]第特66号）。

（三）关联交易对经营状况和财务状况的影响

本公司具有独立的采购、生产、销售系统，在销售及采购环节发生的关联交易均为公司经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

（四）公司独立董事关于近三年及一期重大关联交易事项的意见

本公司独立董事已对本公司报告期的关联交易协议及其履行情况进行审核，并发表意见如下：“公司最近三及一期年内所发生的关联交易已依法履行相关决策程序，遵循平等、自愿原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害发行人和非关联股东利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员职务及简要经历

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历
刘萍	董事长、总经理、研发中心主任	男	46岁	2009年5月至2012年5月	历任深圳市新追求公司部门经理，典邦柔性、丹邦柔性总经理。现任本公司董事长、总经理及研发中心主任，兼任丹邦投资集团、典邦科技、广东东邦、广东丹邦董事长，丹邦香港、第比尔国际董事。

王李懿	董事、 副总经理	男	44岁	2009年5月 至2012年5 月	历任湖北省政府发展研究中心科员、深圳市新追求公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任丹邦投资集团董事，广东丹邦董事、总经理，丹依科技、广东东邦副董事长，典邦科技监事。
益天鹏	董事	男	36岁	2009年5月 至2012年5 月	曾任第比尔国际营业经理。现任本公司董事、兼任丹邦香港总经理。
龚艳	独立董事	女	43岁	2009年5月 至2012年5 月	历任中南大学计财处教学经费主管会计、机械学院主管会计、计财处科研财务科科长、计财处会计二科科长，现任湖南中大业翔科技有限公司财务总监、本公司独立董事。
赖延清	独立董事	男	37岁	2009年5月 至2012年5 月	曾任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授，现任中南大学冶金科学与工程学院教授、中南大学轻金属及工业电化学研究所副所长、本公司独立董事。
邹盛和	监事会主席	男	45岁	2009年5月 至2012年5 月	曾任典邦柔性财务部长。现任本公司监事会主席，兼任广东丹邦副董事长，丹邦投资集团、典邦科技、丹依科技、广东东邦董事。
殷鹰	监事、 技术研发 部部长	男	34岁	2009年5月 至2012年5 月	曾任深圳中络电子有限公司部门主管。现任本公司监事、技术研发部部长。
刘绪芳	监事、 资材部课 长	女	35岁	2009年5月 至2012年5 月	曾任德昌电机（深圳）有限公司生产材料控制科主管、晶浩达电子有限公司生产材料控制科主管、东莞新科影音制品厂生产材料控制科主管。现任本公司监事、资材部课长。
唐苗丽	财务负责 人	女	29岁	2009年6月 至2012年5 月	曾任深圳合悦嘉贸易有限公司会计、深圳深信会计师事务所审计员、深圳天健信德会计师事务所项目经理、典邦科技财务主管。现任本公司财务负责人。
吴荔	董事会秘 书	女	33岁	2010年4月 至2012年5 月	曾任东莞宏远工业区股份有限公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

（二）董事、监事、高级管理人员兼职、薪酬及持股情况

姓名	本公司 职务	2010年含税 薪酬情况 (万元/年)	持有本公司 股份数量 (万股)	兼职单位	在兼职单 位的职务	兼职单位与 公司关系
刘萍	董事长、 总经理、	19.80	7,311.60	丹邦投资集 团	董事长	控股股东
				丹邦香港	董事	公司子公司

	研发中心主任			广东丹邦	董事长	公司子公司
				典邦科技	董事长	关联公司
				广东东邦	董事长	关联公司
				第比尔国际	董事	关联公司
王李懿	董事、 副总经理	17.52	540.00	丹邦投资集团	董事	控股股东
				丹依科技	副董事长	公司股东
				广东丹邦	董事、 总经理	公司子公司
				广东东邦	副董事长	关联公司
				典邦科技	监事	关联公司
益天鹏	董事	-	-	丹邦香港	总经理	公司子公司
龚艳	独立董事	5.00	-	湖南中大业翔科技有限公司	财务总监	无关联关系
赖延清	独立董事	5.00	-	中南大学冶金科学与工程学院	教授	无关联关系
				中南大学轻金属及工业电化学研究所	副所长	无关联关系
邹盛和	监事会主席	18.12	540.00	丹邦投资集团	董事	控股股东
				丹依科技	董事	公司股东
				广东丹邦	副董事长	公司子公司
				典邦科技	董事	关联公司
				广东东邦	董事	关联公司
殷鹰	监事、 技术研发部部长	9.04	-	-	-	-
刘绪芳	监事、 资材部课长	6.30	-	-	-	-
唐苗丽	财务负责人	16.20	-	-	-	-
吴荔	董事会秘书	13.60	-	-	-	-

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

(一) 控股股东

本公司的控股股东为丹邦投资集团，丹邦投资集团现持有本公司股份7,311.60万股，占本公司发行前股份的60.93%。丹邦投资集团成立于2001年6月21日，法定代表人为刘萍，注册资本与实收资本均为9,000万元，目前的主要业

务为持有本公司的股权，未开展其他业务。

(二) 实际控制人

刘萍持有发行人控股股东丹邦投资集团100%的股权，具有绝对控股权，是发行人的实际控制人。发行人自设立以来实际控制人未曾发生变化。刘萍的基本情况如下：

刘萍，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：42232719651022****，住所：广东省深圳市福田区国企大厦永裕楼。

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一) 近三年及一期经审计的财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,676.77	2,050.44	4,974.78	3,949.32
应收账款	5,421.10	4,592.96	5,589.65	6,521.74
预付款项	6,799.50	4,507.55	139.06	5,426.55
其他应收款	1,211.48	439.34	283.89	129.15
存货	1,712.44	1,603.33	2,276.99	998.44
流动资产合计	17,821.29	13,193.63	13,264.37	17,025.20
非流动资产：				
固定资产	32,755.46	34,110.28	31,034.46	26,992.52
在建工程	11,643.39	-	1,822.38	402.79
工程物资	7.33	3,803.32	17.17	1.18
无形资产	8,679.55	4,452.01	3,837.09	4,138.22
开发支出	370.95	800.29	752.19	-
递延所得税资产	117.19	109.78	90.15	85.52
非流动资产合计	53,573.87	43,275.69	37,553.44	31,620.23
资产总计	71,395.15	56,469.32	50,817.81	48,645.42

2、合并资产负债表（续）

单位：万元

负债及股东权益	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：				
短期借款	16,760.00	-	-	-
应付账款	1,738.51	1,407.64	1,233.73	1,553.80
预收款项	23.43	48.18	23.27	27.51

应付职工薪酬	322.59	226.21	268.70	307.35
应交税费	146.92	74.48	97.45	140.90
应付利息	68.44	47.77	47.01	49.90
其他应付款	171.85	141.49	171.02	152.45
其他流动负债	21.85	21.84	-	-
流动负债合计	19,253.59	1,967.61	1,841.18	2,231.91
非流动负债：	-			
长期借款	21,200.00	26,000.00	25,900.00	28,000.00
其他非流动负债	204.15	215.08	72.00	72.00
非流动负债合计	21,404.15	26,215.08	25,972.00	28,072.00
负债合计	40,657.74	28,182.69	27,813.18	30,303.91
所有者权益：				
股本	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00
资本公积	6,341.51	6,341.51	6,341.51	331.98
盈余公积	997.95	997.95	470.07	766.62
未分配利润	11,387.67	8,933.25	4,193.07	7,242.91
外币报表折算差额	10.28	13.92	-0.03	-
归属于母公司所有者权益合计	30,737.41	28,286.63	23,004.63	18,341.51
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	30,737.41	28,286.63	23,004.63	18,341.51
负债及所有者权益总计	71,395.15	56,469.32	50,817.81	48,645.42

3、合并利润表

单位：万元

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	10,922.19	20,567.36	18,347.60	17,151.52
减：营业成本	4,984.56	9,563.84	8,455.46	8,008.48
营业税金及附加	1.98	3.77	3.42	-
销售费用	197.19	406.85	238.06	172.20
管理费用	1,893.99	3,924.25	3,447.18	2,861.60
财务费用	1,098.37	1,739.13	1,919.95	1,820.88
资产减值损失	45.46	-57.95	-46.56	679.15
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	2,700.64	4,987.47	4,330.09	3,609.21
加：营业外收入	176.72	754.21	705.75	190.61
减：营业外支出	-	2.79	0.67	42.53
其中：非流动资产处置损失	-	2.79	0.62	32.38
三、利润总额	2,877.37	5,738.89	5,035.17	3,757.28
减：所得税费用	422.94	470.84	372.02	242.93

四、净利润	2,454.42	5,268.05	4,663.14	3,514.35
其中：归属于母公司股东的净利润	2,454.42	5,268.05	4,663.14	3,514.35
少数股东损益		-	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益（元）	0.20	0.44	0.39	
（二）稀释每股收益（元）	0.20	0.44	0.39	
六、其他综合收益	10.28	13.95	-0.03	-
其中：归属于母公司股东的其他综合收益	10.28	13.95	-0.03	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	2,464.71	5,282.00	4,663.11	3,514.35
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	2,464.7	5,282.00	4,663.11	3,514.35
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

4、合并现金流量表

单位：万元

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,907.16	19,762.51	19,140.45	13,392.81
收到的税费返还	492.16	531.17	289.43	361.11
收到的其他与经营活动有关的现金	179.49	768.05	712.13	723.67
现金流入小计	10,578.81	21,061.73	20,142.01	14,477.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,654.16	5,413.18	6,270.49	6,155.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,619.11	3,338.47	3,235.94	2,845.56
支付的各项税费	343.59	584.67	429.68	162.45
支付的其他与经营活动有关的现金	433.21	950.64	954.47	615.86
现金流出小计	6,050.07	10,286.96	10,890.58	9,779.53
经营活动产生的现金流量净额	4,528.74	10,774.78	9,251.43	4,698.07
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	1.77	4.56	809.25
收到的其他与投资活动有关的现金	-	197.00	-	-
现金流入小计	-	198.77	4.56	809.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,614.23	12,390.87	4,418.26	7,471.38
支付其他与投资活动有关的现金	1,032.57			
现金流出小计	14,646.80	12,390.87	4,418.26	7,471.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,646.80	-12,192.10	-4,413.70	-6,662.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款所收到的现金	16,760.00	5,000.00	16,000.00	5,000.00
现金流入小计	16,760.00	5,000.00	16,000.00	5,000.00
偿还债务所支付的现金	4,800.00	4,900.00	18,100.00	100.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,082.94	1,565.10	1,686.89	2,106.87
支付其他与筹资活动有关的现金	5.89	540.00	10.00	55.00
现金流出小计	5,888.83	7,005.10	19,796.89	2,261.87
筹资活动产生的现金流量净额	10,871.17	-2,005.10	-3,796.89	2,738.13
四、汇率变动对现金的影响额	-57.66	-16.92	-15.37	-130.65
五、现金及现金等价物净增加额	695.44	-3,439.34	1,025.46	643.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,535.44	4,974.78	3,949.32	3,305.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,230.88	1,535.44	4,974.78	3,949.32

(二) 近三年及一期非经常性损益情况

依据经天健会计师核验的非经常性损益明细表，近三年及一期本公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：

单位：万元

项 目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-2.79	1.39	-32.38
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	178.35	188.33	208.40
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	176.72	752.42	703.60	189.70
4、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
5、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	1.79	0.08	-9.24
7 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
非经常性损益合计	176.72	929.78	893.40	356.48
减：所得税	26.51	112.71	105.76	22.21
少数股东损益	-	-	-	-
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	150.21	817.06	787.64	334.27
归属于母公司所有者的净利润	2,445.42	5,268.05	4,663.14	3,514.35
扣除非经常性损益后的净利润	2,295.21	4,450.99	3,875.50	3,180.08

近三年及一期，本公司非经常性损益对当期经营成果的影响均较小，2008-2010年及2011年1-6月非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比重分别为9.51%、16.89%、15.51%和7.23%，对公司经营业绩无重大影响。

(三) 主要财务指标

项目	2011年6月末 /2011年1-6月	2010年末 /2010年	2009年末/ 2009年	2008年末/ 2008年
流动比率	0.93	6.71	7.20	7.63
速动比率	0.84	5.89	5.97	7.18
资产负债率(母公司)	49.78%	49.81%	54.62%	62.30%
应收账款周转率(次/年)	4.36	4.04	2.88	3.36
存货周转率(次/年)	6.02	4.93	5.16	8.42
息税折旧摊销前利润(万元)	5,414.71	10,506.98	9,459.67	7,310.66
利息保障倍数	4.30	4.67	3.99	3.10
每股经营活动的现金流量(元/股)	0.38	0.90	0.77	0.46
每股净现金流量(元/股)	0.06	-0.29	0.09	0.06
无形资产(扣除土地使用权、水面 养殖权和采矿权等)后)占净资产的 比例	15.41%	14.26%	14.81%	20.14%

注：2011年1-6月的应收账款周转率、存货周转率已做年化处理

(四) 管理层讨论与分析

1、资产结构分析

2008-2010年末、2011年6月末，公司资产总额分别为48,645.42万元、50,817.81万元、56,469.32万元、71,395.15万元，公司资产规模呈稳定增长趋势。

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例均低于35%，流动资产主要是货币资金、应收账款及存货；非流动资产占总资产的比例均超过65%，以固定资产、无形资产及在建工程为主，其中占比最高的固定资产主要是与生产经营密切相关的机器设备、检测设备、运输工具及房屋建筑物等，资产使用状况良好。

2、负债结构分析

2008-2010年末，本公司非流动负债占比在90%以上。流动负债主要为公司采购原材料及固定资产形成的应付账款，供应商给予本公司的信用账期一般为60-90天，表明公司在供应商的信用状况良好。非流动负债主要为公司向国家开发银行及招商银行的长期借款。

2011年6月末，公司流动负债为19,253.59万元，占负债总额的比例为47.36%，流动负债大幅增加，主要是由于公司分别与招商银行、建设银行、民生

银行签订了短期借款合同，向上述银行分别借款 10,000 万元、3,960 万元、2,800 万元。上述借款主要用于购买募投项目所需的土地使用权及地上建筑物、生产用机器设备及补充流动资金等。

报告期各期末，公司负债总额较大，主要是公司处于产能扩张期，对资金需求量较大，借款金额较大所致，亦体现了公司具有良好的银行资信和融资能力。

3、盈利能力分析

2008-2010 年、2011 年 1-6 月，本公司分别实现营业收入 17,151.52 万元、18,347.60 万元、20,368.09 万元、10,922.19 万元。公司自成立以来，专注于 FPC、COF 柔性封装基板及 COF 产品的研发、生产与销售。报告期内，主营业务收入占营业收入的比例均在 99%以上，主营业务突出。其他业务收入主要为租赁收入等，占比小，报告期内变动不大。

报告期内，公司不断优化产品结构，持续提升高技术含量、高附加值产品的比重。COF 柔性封装基板及 COF 产品销售收入占比逐年上升，2011 年 1-6 月二者合计占比达 79.89%；FPC 销售收入占比逐年下降，由 2008 年占比 44.50%下降到 2011 年 1-6 月的 21.03%。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于外销收入，且逐年增长。外销收入由 2008 年的 17,043.04 万元提高到 2010 年的 20,011.92 万元，2011 年 1-6 月外销收入也达到 2010 年的 53.56%。

2008-2010 年、2011 年 1-6 月综合毛利率分别为 53.28%、53.72%、53.41%、54.14%，综合毛利率保持较高的水平，保持在 50%以上。

2008-2010 年、2011 年 1-6 月，归属于母公司的净利润分别为 3,514.35 万元、4,663.14 万元、5,268.05 万元、2,454.42 万元。2008-2010 年公司净利润保持逐年上升。

4、现金流量分析

报告期内，公司经营现金流量逐年增加，经营活动产生的现金流量净额分别是 4,698.07 万元、9,251.43 万元、10,774.78 万元、4,528.74 万元，分别占对应期间实现净利润的 133.68%、198.39%、204.53%、184.51%，三年及一期累计

数为 29,253.02 万元，占三年及一期累计净利润的 183.98%，超过净利润 13,353.06 万元，经营活动产生的现金流量充足。2008-2010 年、2011 年 1-6 月经营活动现金流量充足主要得益于报告期内应收账款回收正常，存货库存控制良好，以及公司的谈判地位和议价能力不断提高。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额报告期内均为负数，且逐年减少，分别为-6,662.13 万元、-4,413.70 万元、-12,192.10 万元、-14,646.80 万元，主要是包括两个方面：（1）公司近几年正处于持续扩大产能、调整产品结构阶段，为增加高附加值的 COF 柔性封装基板及 COF 产品产能而新购置了机器设备及检测设备等；（2）实施募投资项目收购的土地及地上建筑物、购买的机器设备。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量逐年减少，分别为 2,738.13 万元、-3,796.89 万元、-2,005.10 万元、10,871.17 万元。

（五）股利分配政策

公司依据有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配。

报告期内，公司未进行股利分配。

经公司2010年第二次临时股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至2011年6月30日，母公司未分配利润为11,454.14万元。

（六）控股子公司的基本情况

公司目前有2家子公司，具体情况如下：

1、丹邦科技（香港）有限公司

丹邦香港成立于2007年10月26日，现为公司全资子公司，法定股本为1,400万港元，经营期限15年，注册地址为香港九龙红磡马头围道39号红磡商业中心A座508室。

截至2010年12月31日，丹邦香港的总资产为4,685.00万元，净资产为1,223.53万元，2010年度实现主营业务收入995.62万元，净利润-3.02万元（以上数据经天健会计师审计）。

截至 2011 年 6 月 30 日，丹邦香港的总资产为 9,020.45 万元，净资产为 1,229.11 万元，2011 年 1-6 月净利润 2.94 万元（以上数据经天健会计师审计）。

2、广东丹邦科技有限公司

2009 年 8 月 10 日，东莞市对外贸易经济合作局以东外经贸松[2009]18 号批复同意丹邦科技和丹邦香港共同投资设立中外合资企业，投资总额 10,000 万元，注册资本与实收资本均为 5,000 万元，合资企业经营期限为 50 年，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人刘萍，注册地为东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 C 区 BC-18。目前，该公司尚无业务发生，将作为本次募集资金投资项目的实施主体。

截至 2010 年 12 月 31 日，广东丹邦的总资产为 6,909.21 万元，净资产为 4,970.84 万元，2010 年度实现主营业务收入 0.00 万元，净利润-8.85 万元（以上数据经天健会计师审计）。

截至 2011 年 6 月 30 日，广东丹邦的总资产为 20,735.92 万元，净资产为 4,957.76 万元，2011 年 1-6 月净利润-13.08 万元（以上数据经天健会计师审计）。

第四节 募集资金运用

本次发行后，预计募集资金将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	项目核准机关	项目核准文号	环评核准文号
基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	42,500.00	东莞松山湖科技产业园区经济贸易发展局	东发改松[2010]8号	粤环审[2011]130号
合计	42,500.00	—	—	—

募集资金投资项目投资进度情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资	第一年		第二年		第三年	
		投资额	比例	投资额	比例	投资额	比例
基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	42,500.00	13,600.00	32.00%	11,400.00	26.82%	17,500.00	41.18%

注：第一年指从项目开始建设起至其后第 12 个月的期间，第二年、第三年依此类推。

上述项目投资总额为 42,500.00 万元，拟全部运用本次发行募集资金。若实

际募集资金少于募集资金计划使用额，公司将通过银行贷款和自筹资金予以解决；若实际募集资金超过募集资金计划使用额，超出部分将用于补充公司流动资金。

本次募集资金投资项目顺应了COF柔性封装基板向线路微细化和薄型化方向发展以及COF封装技术将成为显示驱动IC封装的趋势，可巩固并充分利用公司在COF柔性封装基板方面的优势。项目的实施将进一步扩大附加值高、技术壁垒高的COF柔性封装基板及COF产品的产能，可进一步充分利用公司自产FCCL、COF柔性封装基板的优势，提高COF柔性封装基板及COF产品收入占比，不断完善公司的产业链优势，提升公司产品技术含量和竞争力，进一步优化产品结构。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场风险

公司主要竞争对手为日本日立电线、日本三井金属矿业、韩国LG微电子、韩国STEMCO、日本住友金属矿山等跨国企业。日本、韩国及欧美等国家和地区是全球电子信息品主要生产地，这些国家和地区的主要竞争对手成立时间较早，且大多隶属于全球知名的跨国集团，在生产规模、资金规模、研发实力及技术水平等方面具有明显优势。未来，公司与国际竞争对手的竞争将日益激烈，公司可能面临因市场竞争能力下降导致盈利能力下滑的风险。

（二）技术风险

1、技术开发风险

随着IC产品的应用发展迅速，IC封装不断向小型化、微型化的方向发展，出现了很多新的封装技术和封装形式。如果公司未来不能持续加大研发投入，不能实现高端2L-FCCL、COF超微细化线路及COF封装等技术的持续升级，不能持续提升产品加工技术及制造工艺，将难以保持公司在行业内的竞争优势，可能导致公司产品在技术先进性、产品可靠性及生产工艺技术滞后于市场发展要求或落后于

竞争对手，使得公司产品的竞争力和市场份额下降。

2、核心技术人员流失和核心技术失密风险

公司产品和技术的升级换代、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，虽然公司已经同核心技术人员签订了保密合同，且公司的核心技术不严重依赖部分技术人员，但如果核心技术人员流失、关键技术失密，仍将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

(三) 控股股东用于出资的无形资产可能存在减值的风险

2007年5月，控股股东丹依发展以“UV固化可剥离压敏胶膜”、“一种无胍刻蚀液”、“一种潜伏性固化剂的制造方法”及“用于芯片搭载及封装的电绝缘树脂浆”四项发明专利评估作价对丹邦有限出资4,623万元。四项发明专利对公司核心竞争力的形成起到了决定性的作用，并且公司拥有的其他多项专利技术是在上述四项专利的基础上的延伸和发展，但由于上述无形资产收益年限比较长，如果未来出现新的重大技术突破或者全球经济环境发生重大不利变化，四项发明专利存在减值的风险。

(四) 财务风险

1、资产抵押风险

截至2011年6月30日，公司将主要生产用房屋建筑物、机器设备、发明专利等资产为公司的银行借款提供抵押或质押担保。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该房屋建筑物、机器设备及专利技术的所有权，进而影响正常生产经营的风险。

2、汇率波动风险

自2005年7月21日我国改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率总体呈上升趋势，未来人民币仍可能保持升值趋势。本公司主要采用美元结算，若人民币持续不断升值，将导致本公司出现汇兑损益，可能影响本公司的经营业绩。

(五) 募集资金投资项目风险

本公司本次募集资金项目实施过程中，存在项目的建设周期被延长、项目投

产后市场情况变化达不到预期效果等不确定因素，从而影响本次募集资金投资项目预期收益的实现。

（六）企业所得税税收优惠政策变化的风险

2007年5月，公司外资股权比例从25%变更为12.67%，成为“外资比例低于25%”的外商投资企业。根据国家税务总局有关规定，公司于2007年5月外资比例低于25%之后应补缴已免征、减征的企业所得税税款。

但根据深圳市地方法规的相关规定，公司作为在深圳经济特区内设立的生产性企业，可享受按优惠税率及减半征收企业所得税的税收优惠政策。公司2006年为开始获利年度，据此2006年度至2007年度可免征企业所得税，2008年度至2010年度减半征收企业所得税。深圳市南山区地方税务局于2011年1月24日出具确认函确认发行人无需补缴2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款。但若该具体行政行为被国家有权机关作出撤销的决定或人民法院作出撤销或认定无效的判决，则发行人2006年1月1日起至2010年12月31日期间已免征、减征的企业所得税税款可能存在被追缴的风险。

二、其他重要事项

（一）重要合同

截至2011年6月30日，发行人及发行人合并报表范围内的公司已签署、正在履行的重大合同主要包括：（1）借款合同6份，其中与国家开发银行合同项下的贷款余额为18,200万元，与招商银行合同项下的贷款余额为13,000万元，与建设银行合同项下的贷款余额为3,960万元，与民生银行合同项下的贷款余额为2,800万元；（2）担保合同8份。（3）设备采购合同9份。

（二）对外担保事项

截至本招股意向书摘要签署之日，公司不存在任何对外担保事项。

（三）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司无任何对财务状况、经营成果、声

誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司控股股东及控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未曾有受到刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

单位名称	住所	联系电话	传真	经办人姓名
发行人：深圳丹邦科技股份有限公司	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼	0755-26511518	0755-26981718	吴荔
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层	0755-82130833	0755-82130620	甘燕 崔威
发行人律师：国浩律师集团（深圳）事务所	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24D. E	0755-83515666	0755-83515333	王彩章 朱永梅
财务审计机构：天健会计师事务所有限公司	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层塔楼 A701-A702	0755-82903449	0755-82990751	张希文 黄琼
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	-
收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行	深圳市深南东路地王商业大厦附楼首层	0755-82461390	0755-82461376	-
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路 5045 号	0755-82083333	0755-82083164	宋丽萍

二、发行时间安排

询价推介时间：	2011 年 8 月 31 日~2011 年 9 月 2 日
定价公告刊登日期：	2011 年 9 月 6 日
申购日期和缴款日期：	2011 年 9 月 7 日
预计股票上市日期：	发行结束后尽快安排上市

第七节 备查文件

招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：工作日上午9：00至12：00，下午14：00至17：30，也可通过深圳证券交易所指定网站查阅，网址：www.cninfo.com.cn。

（以下无正文）

（此页无正文，系深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要盖章页）

